

導熱膠 AP Series

Thermal Adhesive



- 可導熱、可黏接 (Thermally conductive, adhesive)
- 室溫固化 (Cures at room temperature)
- 無毒、無刺激性氣味 (Non-toxic, odorless, non-irritating)
- 可在 -50~200°C 之間 長期使用 (Long-term use between -50~200°C)

項目/類別		Test Method	AP-080	AP-100	AP-150
Before curing 固化前	Color 顏色	—	White 白色		
	State 狀態	—	Semi-flowable 半流淌		
	Dry time table 表乾時間	GB/T-13477.5	5~15Min		
	Mixing Ratio 混合比例	—		Single-component, non-mixing 單組分 · 不混合	
After curing 固化後	Thermal Conductivity 導熱係數	ASTM D5470	≥0.8 W/mk	≥1.0 W/mk	≥1.5 W/mk
	Bonding Strength 黏接強度	GB/T-11211	≥1.6 Mpa	≥1.5 Mpa	≥1.5 Mpa
	Tensile Strength 抗拉強度	GB/T-528	≥1.5 Mpa		
	Hardness 硬度	GB/T-531.1	Shore A 60±10		
	Elongation 撕裂延伸率	GB/T-528	150~200%	120~150%	120~150%
	Breakdown Voltage 擊穿電壓	GB/T-1695	≥20 KV/mm	≥18 KV/mm	≥15 KV/mm
	Temperature Range 耐溫範圍	GB/T 1692	-50~200°C		